



HICC

天堂之芯

国家“芯火”双创基地（平台）
国家集成电路设计杭州产业化基地|孵化器
浙江省集成电路设计公共技术平台

2019 年第 10 期 （总第 321 期） 2019.10.31 www.hicc.org.cn

■本地要闻

- ▲首家！平头哥宣布开源 RISC-V 内核 MCU 芯片设计平台
- ▲士兰微旗下产品荣获 2019 年“中国芯”优秀技术创新称号
- ▲海康威视成立 10 亿基金投资集成电路领域
- ▲之江实验室启动新型架构芯片项目，欲突破冯诺依曼内存墙难题
- ▲华澜微：加大研发攻克技术难题，让中国“芯”大规模产业化
- ▲国内芯片封测龙头-长电科技助力绍兴建设“国家集成电路创新中心”
- ▲绍兴越城打造“芯”高地，晶圆测试及晶圆重构项目签约落地
- ▲曾获总理点赞，光珀 3D 图像传感器及芯片生产线项目签约丽水

■业界动态

- ▲重磅！国家集成电路产业投资基金二期成立，注册资本超 2000 亿
- ▲长沙 IC 新政出炉，鼓励设立 100 亿元新一代半导体产业发展投资基金
- ▲集成电路，10 大政策！上海临港巨额补贴 EDA 等！
- ▲成都集成电路产业规模排名全国第五，高新区设定 2022 年 IC 目标

■ 通知公告

▲ 关于举办集成电路专题培训班的通知

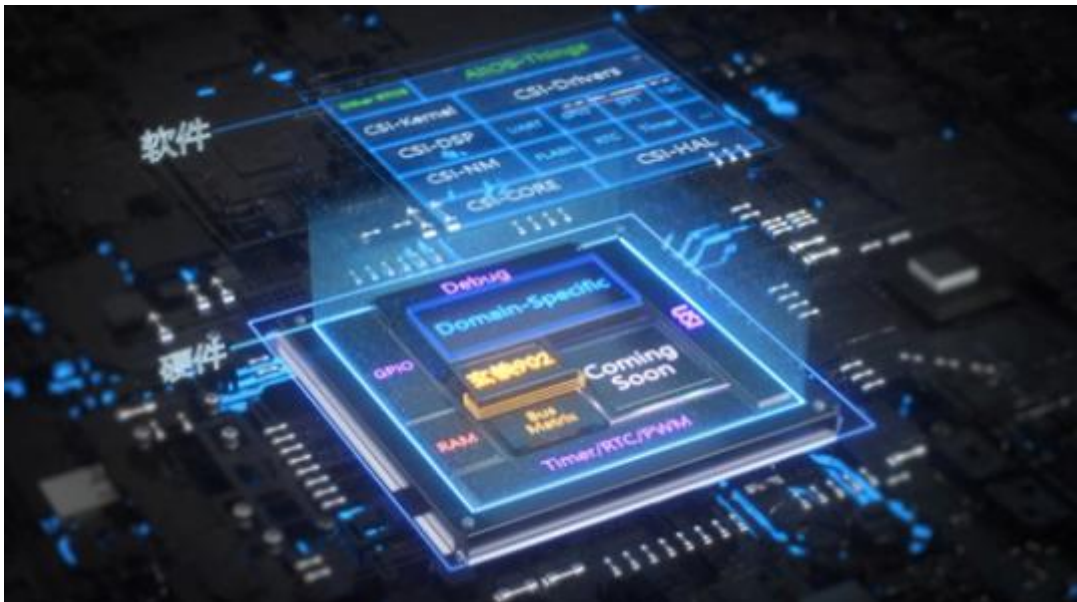
▲ 中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见

本地要闻

首家！平头哥宣布开源 RISC-V 内核 MCU 芯片设计平台

集微网消息（文/小如）10月21日，在乌镇互联网大会期间平头哥宣布开源其 MCU 设计平台，成为国内首家开源芯片设计平台的公司。

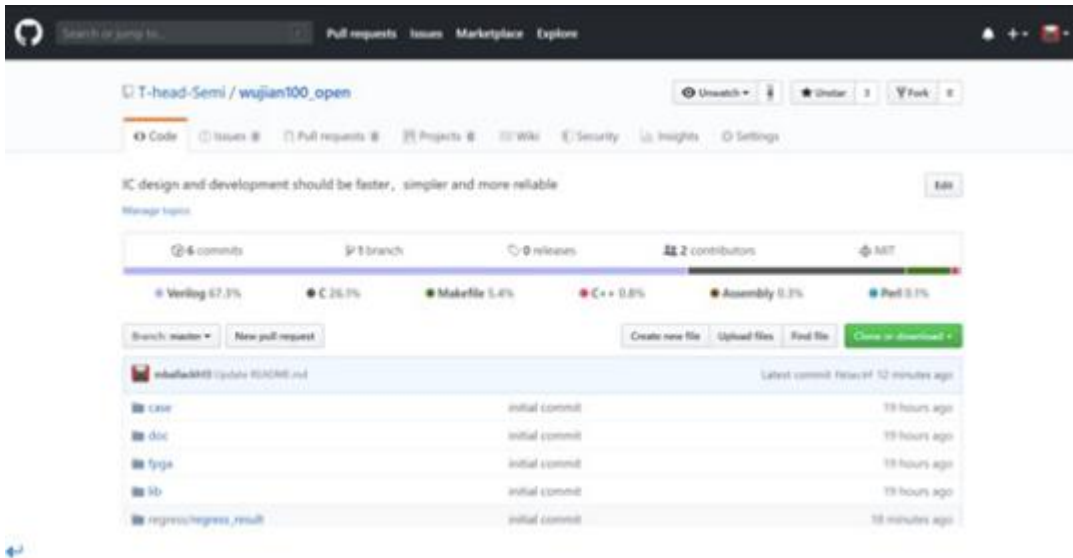
据悉，开源 MCU 芯片设计平台面向 AIoT 时代的定制化芯片设计需求，目标群体包括芯片设计公司、IP 供应商、高校及科研院所等，开发者都能基于该平台设计面向细分领域的定制化芯片，IP 供应商可以研发原生于该平台的核心 IP，高校和科研院所则可开展芯片相关的教学及科研活动。



该平台包含处理器、基础接口 IP、操作系统、软件驱动和开发工具等模块，搭载基于 RISC-V 架构的玄铁 902 处理器，提供多种 IP 及驱动，能让用户快速集成、快速验证，减少基础模块开发成本。

今年 8 月 29 日，平头哥发布了一站式芯片设计平台“无剑”，无剑平台由 SoC 架构、处理器、各类 IP、操作系统、软件驱动和开发工具等模块构成，是一款系统芯片开发的基础共性技术平台。无剑 SoC 芯片平台能够将 AIoT 芯片的设计周期缩短 50% 以上，成本压缩 50% 以上。据平头哥半导体研究员孟建熠介绍，无剑 SoC 平台可以采用开放授权的方式获取，其目标就是被集成。

据悉，MCU 芯片设计平台得益于平头哥无剑 SoC 平台“快”、“准”、“稳”、“全”能力的加持。



此外，MCU 芯片设计平台开源代码包括基础硬件代码和配套软件代码两部分，现已公布在 GitHub 开源社区。

（来源：集微网）

士兰微旗下产品荣获 2019 年“中国芯”优秀技术创新称号

10 月 25-26 日，第十四届中国集成电路产业促进大会在青岛隆重举行，大会同期举办的“中国芯”优秀产品征集结果发布，旨在对国内集成电路领域产品创新、技术创新和应用创新成果进行表彰，发挥示范效应，影响和带动行业发展。据介绍，2019 年的“中国芯”结果与我国集成电路产业的区域分布情况一致，本届“中国芯”征集活动中，来自上海、深圳、北京的企业和产品数均占总数的一半以上，报名企业中，上海的企业 26 家，深圳 21 家，北京 20 家，累计占据报名企业总数的 54%。征集产品中，上海企业的产品 49 款，深圳 40 款，北京 23 款，累计占征集产品数量的 59%。

其中，“优秀技术创新产品”共征集来自 83 家企业的 100 款芯片产品，产品数量占征集总数的 53%。从产品类型看，微处理器/控制器、电源管理、射频芯片的征集产品数累计占“优秀技术创新产品”征集总数的 46%，展示了国内芯片企业以市场为牵引的技术创新方向。从应用领域看，工业应用、无线/有线网络通信、智能手机依然是技术创新的主阵地，产品数累计占总数的 49%，此外，汽车电子和人工智能也成为芯片企业技术创新的新焦点，累计占 15%。

值得关注的是，作为国内规模最大的集成电路芯片设计与制造一体（IDM）的企业之一的杭州士兰微电子股份有限公司，旗下产品“1350V RC 逆导型绝缘栅双极型

晶体管（IGBT）SGT20T135QR1P7”荣获2019年“中国芯”优秀技术创新产品称号。此次获奖充分体现出行业以及市场对士兰微多年深耕打造优质分立功率器件的认可。

同时，士兰微紧跟市场热点，在近期倍思发布的一款45W大功率可以给笔记本快充的移动电源，采用的就是Silan移动电源双路升降压快充方案。而在面对iPhone11上市推动快充产业的全面爆发，士兰微已经针对小功率快充市场推出了一款内置MOS初级主控芯片SD8666QS，还用有自己的USB PD3.0认证协议芯片SD8602，可为客户提供多种选择。

据悉，士兰微在传统主营业务的LED芯片方面，公司也不断在对产品进行优化升级，近期推出了ASOP7+桥堆+二极管/SOP7+二极管/SOP4+二极管多系列LED照明驱动方案，方案集成化程度高，芯片外围高度简化，减少了元器件数量，相当大程度上降低了BOM成本，兼容DOB和非DOB方案，整体方案非常具有市场竞争力，可广泛应用于球泡灯和T管等多种LED照明市场。

得益于中国电子信息产业的飞速发展，士兰微电子的技术与产品已经成功覆盖了消费类产品的众多领域，在多个技术领域保持了国内领先的地位，如绿色电源芯片技术、MEMS传感器技术、LED照明和屏显技术、高压智能功率模块技术、第三代功率半导体器件技术、数字音视频技术等。其技术水平、营业规模、盈利能力等各项指标在国内同行中均名列前茅。伴随着新一轮产业变革的加速推进，集成电路产业迎来强劲的发展动能。在国家大基金的强力支持下未来公司将进一步产能升级，实现集成电路的高质量发展。

（来源：证券时报网）

海康威视成立 10 亿基金投资集成电路领域

海康威视近日公告称，公司审议通过了《关于投资设立产业投资基金合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、中电海康集团有限公司、杭州高新创业投资有限公司、中电基金管理（天津）有限公司，共同投资设立杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（来源：C114）

之江实验室启动新型架构芯片项目，欲突破冯诺依曼内存墙难题

10月8日，之江实验室正式启动“新型架构芯片”项目，该项目旨在利用体系架构和关键器件的突破，解决经典冯诺依曼体系架构的“内存墙”等问题，实现人工智能算力和能效的提升。

据之江实验室官方消息，该项目于2019年9月在之江实验室正式立项。目前，27位来自中国科学院和浙江大学的科学家汇聚之江实验室，计划通过两年左右的时间，突破存算一体化芯片和类脑计算芯片的核心技术。下一步，研究团队还将对类脑计算系统的体系架构、核心软件等进行研究和开发。

2017年9月6日，之江实验室在中国（杭州）人工智能小镇正式成立，该实验室由浙江省政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同出资打造，以网络信息、人工智能为研究方向。

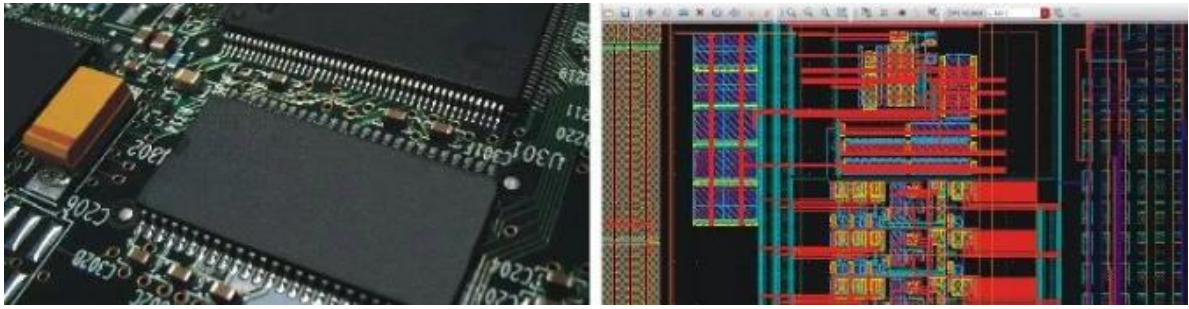
据悉，之江实验室首批5个重大项目分别是先进人工智能算法平台基础理论与关键技术研究、智能无障感知芯片与系统、多中心协同的生物学智能信息技术平台构建、城市大脑科研与公共服务平台以及先进工业互联网安全平台，其第二批项目已于2018年底启动。之江实验室聘任了潘云鹤院士和邬江兴院士分别作为实验室人工智能领域和网络安全领域的首席科学家，引进的“图灵奖”获得者、国际脑机接口领域最有影响力的科学家等20多位海内外高层次人才作为科研骨干。

10月8日，中国科学院院士刘明受聘之江实验室新型智能计算系统研究中心首席科学家。刘明院士长期致力于微电子科学技术领域的研究，在存储器模型机理、材料结构、核心共性技术和集成电路的微纳加工等方面做出了系统性、创造性的贡献。

（来源：之江实验室）

华澜微：加大研发攻克技术难题，让中国“芯”大规模产业化

一枚小小的芯片，里面却排列着上亿个晶体管，蕴含着沉甸甸的科技分量。在集成芯片领域，中国以往一直高度依赖进口，杭州华澜微电子股份有限公司（以下简称华澜微）却成功打破了“进口神话”，研发出具有自主知识产权的中国芯片。如今，华澜微的存储控制器芯片业务出口量位居全国第一，助力中国“芯”澎湃崛起。



年研发成本高达数千万元

“半导体产业不是单靠花钱就能够满足客户的需求，而是靠长期技术积累的结果。”在华澜微的企业发展法则里，技术是引领企业成长的主要动能。



华澜微公司副总裁周斌告诉记者，华澜微诞生于2011年。2012年，华澜微就自主设计了国内第一颗固态硬盘（SSD）控制芯片等存储控制芯片，这是因为他们之前已经做了十多年的技术积累。

十年磨一剑，这项成果的发布不仅意味着中国首次掌握了产业化制造计算机硬盘的核心技术，打破多年来的国际垄断，更重要的一点是，在国内产业应用中，企业有了更大的掌控权。

此后，围绕着这一核心技术，华澜微持续加码研发力度，逐步衍生了一系列产品，比如存储卡控制器芯片、固态硬盘控制器芯片、SAS控制器芯片等，已成为国内存储

领域控制器芯片品种最为齐全的科技公司之一。

“华澜微一贯重视在新产品和新技术领域的研发投入，每年我们在技术方面的投入都很大。”周斌说，华澜微内部的研发人员占总人数 70%以上，年研发成本高达数千万元。

目前，华澜微正在努力攻克一项新技术——高端企业级云存储固态硬盘控制器芯片和企业级磁盘阵列控制器芯片。这类芯片是搭建大数据和云存储系统的核心，它的作用好比“高速公路”，成千上万的存储介质通过这类芯片搭建成大数据系统。

“这项技术被美国两家企业所垄断，国内的大数据存储设备企业需要向他们采购这种关键芯片，产业命脉被掐在别人手里。”周斌说，华澜微正在努力研发此类芯片，如今关键技术难题已基本解决，预计明年年中正式面世。

（来源：杭州经信）

国内芯片封测龙头-长电科技助力绍兴建设“国家集成电路创新中心”

10月29日，长电科技发布公告，其控股子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.（以下简称“星科金朋”）拟与股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）等共同投资设立合资公司。

长电与国家大基金、绍兴越城越芯数科股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江省产业基金有限公司（以下简称“浙江省产业基金”）共同投资在绍兴设立合资公司，建立先进的集成电路封装生产基地。

根据公告，该合资公司注册资本为人民币 50 亿元，拟定名称为长电集成电路（绍兴）有限公司，拟定经营范围包括半导体集成电路和系统集成的技术开发、测试和生产制造；半导体集成电路和系统集成的技术转让，技术服务及产品销售服务。

（来源：长电科技）

绍兴越城打造“芯”高地，晶圆测试及晶圆重构项目签约落地

集微网消息（文/图图）10月19日，在2019“同心·越城”大会上举行了集成电路产业和古城保护利用专项推介及其签约仪式，共计达成投资项目 23 个，投资总

额达 258 亿元。



此次集中签约的项目包括晶圆测试及晶圆重构等。

2018 年 5 月 18 日，越城区再添一个重大新兴产业项目，总投资 58.8 亿的中芯绍兴项目开工。业内人士一致认为，中芯绍兴项目将为绍兴集成电路产业的带来虹吸效应。

为促进集成电路产业的发展，绍兴市越城区设立集成电路产业基金，规模 20.2 亿元。本基金将投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司项目，投资项目主要为微机电和功率器件集成电路生产线。

2018 年 9 月，在中国（绍兴）首届集成电路产业高峰论坛上，“绍兴集成电路小镇规划”发布，该规划将以集成电路产业为主导，着重引进集成电路设计-制造-封装-测试-装备等全产业链项目形成产业集群。这也标志着中国首个以集成电路命名的小镇在越城区落地。（校对/小北）

（来源：集微网）

曾获总理点赞，光珀 3D 图像传感器及芯片生产线项目签约丽水

集微网消息，10 月 20 日，丽水经济开发区与杭州光珀智能科技有限公司、中核产业基金（北京）管理有限公司签订光珀 3D 图像传感器及芯片生产线项目三方框架协议。



图片来源：丽水经济开发区

该项目总投资 50 亿元，首期投资 20 亿元，将建立光电半导体产业基地平台，并通过自主核心技术和购置先进的国内外生产设备，进行三条智能化先进生产线建设。最终将形成年营业收入 100 亿元，将带动智能汽车、无人机和机器人等人工智能领域对高性能低成本视觉感知的需求。

据丽水经济技术开发区消息，项目曾赢得国务院总理李克强 2 次点赞，项目负责人于 10 月 15 日受到副总理孙春兰接见，获得国家发改委关于“基于面阵单光子计数器的高性能低成本激光雷达研发及产业化项目”补助资金 5000 万元，省金控投资 3000 万元。公司目前拥有硕士 35 人，博士及博士后 8 人。

杭州光珀智能科技有限公司专注于 ToF 传感器技术，其产品主要应用领域包括安防监控、汽车自动驾驶、机器人导航、三维建模、虚拟/增强现实、人机交互、机器 3D 视觉等。（校对/图图）

（来源：集微网）

业界动态

重磅！国家集成电路产业投资基金二期成立，注册资本超 2000 亿

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，比一期注册资本的两倍还多。

公开数据显示，国家大基金二期共有27位股东，均为企业法人类型。其中前五大股东分别为财政部、国开金融有限责任公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中国烟草总公司。其中财政部和国开金融持股比例超过10%，分别为11.02%和10.78%。

国家大基金兼具产业引导和财务投资双重角色，投资领域覆盖集成电路设计、制造、封装测试等全产业链。国家大基金一期加二期撬动社会资本总规模预计超过1万亿元，将为产业发展提供新动力，未来几年国内集成电路产业将进一步快速发展。

2018年3月，有媒体报道称，大基金二期方案已上报国务院并获批。4月25日，工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因在国新办举行的发布会上表示，国家集成电路产业基金正在募集第二期资金。

“大基金”即国家集成电路产业投资基金股份有限公司，是在2014年9月由工信部、财政部的指导下设立，其成立目的是为了扶持中国本土芯片产业，以减少对国外厂商的依赖。

此前的2014年6月，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，部署充分发挥国内市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展。

作为专注芯片行业的“国家队”，大基金首期实际募集规模1387.2亿，投资覆盖了集成电路全部产业链。根据公开数据披露，截至2018年9月12日，大基金有效承诺额超过1200亿元，实际出资额达到1000亿元，投资进度与效果均好于预期。

国家大基金二期的成立，以及几乎为一期两倍的注册资本，可以窥得国家扶持集成电路产业的决心。在大基金二期的带动下，我国集成电路产业将迎来新的密集投资期。

据国家大基金总裁丁文武近期讲话，国家大基金二期主要有两点：

- 1、首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品；继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨

设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

- 2、打造一个集成电路产业链供应体系，每个环节要与用户有机地结合起来，尤其是国产装备、材料等上游产业链环节。结合上述一期资金的投向总结来看，大基金二期可能重点向上游设备和材料领域倾斜。

也有分析认为，二期将加重 IC 设计的比重，预计围绕 IoT/5G/AI/智能汽车等的 IC 设计、内存、SiC/GaN 等化合物半导体可能成为二期投资的三大方向。

此前，国家大基金曾在半导体集成电路零部件峰会上，透露未来投资布局及规划：

1.支持龙头企业做大做强，提升成线能力

- 首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业**做大做强**，形成系列化、成套化装备产品
- 对照《纲要》继续**填补空白**，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全

2.产业聚集，抱团发展，组团出海

- 推动建立专属的集成电路装备产业园区，吸引装备零部件企业集中投资研发中心或产业化基地，实现产业资源和人才的聚集，加强上下游联系交流，提升研发和产业化配套能力，形成产业聚集的合力
- 积极推动国内外**资源整合、重组**，壮大骨干企业，培育中国大陆“应用材料”或“东京电子”的企业苗子

3.持续推进国产装备材料的下游应用

- 充分发挥基金在全产业链布局的优势，持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同，加强基金所投企业间的上下游结合，**加速装备从“验证”到批量采购的过程**，为本土装备材料企业争取更多地市场机会，督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备材料提供工艺验证条件，扩大采购规模

（来源：智东西）

长沙 IC 新政出炉，鼓励设立 100 亿元新一代半导体产业发展投资子基金

集微网消息（文/小如）近日，《长沙市加快新一代半导体和集成电路产业发展若干政策》印发，长沙将主要支持集成电路设计和设备、第三代半导体、功率半导体器件及集成电路的行业融合应用。

长政办发〔2019〕35号

长沙市人民政府办公厅 关于印发长沙市加快新一代半导体和 集成电路产业发展若干政策的通知

各区县（市）人民政府，市直机关各单位：

《长沙市加快新一代半导体和集成电路产业发展若干政策》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。



近日，长沙市委书记胡衡华专题调研集成电路产业链时也指出，长沙发展集成电路产业的重点在于设计和设备、第三代半导体、功率半导体以及集成电路在北斗、智能驾驶等领域的融合应用，要结合现有产业基础和优势出台专项政策，聚焦发展重点给予支持，形成比较优势。

以下为该政策的重点内容。

设立规模为3亿元的产业发展专项资金，用于支持新一代半导体和集成电路产业及企业发展，重点支持企业研发创新、人才培养等。

鼓励发起设立长沙市新一代半导体和集成电路产业发展投资子基金，子基金规模可增加至100亿元。

对企业的晶圆（MPW）试流片、全掩膜（FULL MASK）工程产品首次流片，购买IP核费用，分别给予该企业实际交易额60%，50%，50%的补贴，最高补贴500万元。

支持企业采购长沙市内企业生产的材料、芯片、关键零部件及设备，按照采购金额的10%给予补贴，最高补贴500万元。

重点支持在 5G 商用、新能源汽车、智能终端、智能网联、北斗等领域的示范应用，每年在长沙市范围内择优评选一批示范应用项目，给予项目技术、产品及服务提供商实际研发投入 30% 的奖励，最高 200 万元。

经认定的新一代半导体和集成电路企业高级管理、技术人才，年度工资薪金收入个人所得税实缴纳 1 万元/年以上的，采用“以奖代补”方式予以返还。

支持国内外新一代半导体和集成电路企业落户长沙，对实际到位资金达到 1 亿元以上的，按其实收资本的 5% 给予一次性奖励，耽搁企业最高 2000 万元。

支持新一代半导体和集成电路领域高端人才来长沙创业，经认定后以股权投资和资金补助结合的方式给予每个高端人才（团队）项目最高 1000 万元资金支持，企业获利后，根据其地方经济社会贡献，给予连续 3 年 100% 的奖励，最高 500 万元。（校对/图图）

（来源：集微网）

集成电路，10 大政策！上海临港巨额补贴 EDA 等

今天下午，中国(上海)自由贸易试验区临港新片区发布了集聚发展集成电路产业若干措施，其中提出了 10 项支持条款。

支持 EDA 软件购买和研发。对购买 EDA 设计工具软件(含软件升级费用)的企业并实际在临港新片区内开展办公研发的企业，按照实际发生费用的 50%，给予年度最高 200 万元的支持。对在新片区从事集成电路 EDA 设计工具研发的企业，给予 EDA 研发费用最高 50% 的年度研发资助，总额不超过 3000 万元。

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区发布了集聚发展集成电路产业若干措施，其中提出了 10 项支持条款。

1、支持重大项目优先布局。支持具有国内外重大影响力的集成电路企业设立研发中心和投资产业化项目，支持集成电路产业的跨国公司设立离岸研发中心和制造中心，支持企业申请获得国家级和上海市级集成电路重大专项并对扶持资金予以配套，具体奖励、支持措施由临港新片区管委会专项审议确定。

2、支持核心技术和产品攻关。每年由临港新片区管委会根据国家、上海市等产业和科技创新要求，征集集成电路领域产品需求、遴选优质项目，面向全球招标悬赏

任务承接团队，根据项目需求和专家评议结果，对承担并完成核心技术突破任务的单位(或联合体)给予该项技术研发费用最高 50%的资助。

3、支持企业规模化发展。其中：

(1)对集成电路设计类企业，年度销售收入首次突破 5000 万元、1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的，经认定后分别给予最高不超过 100 万元、150 万元、200 万元、300 万元、500 万元的一次性奖励，每上一个台阶奖励一次、实施晋档补差。

(2)对集成电路制造、封装测试类企业，年度销售收入首次突破 5 亿元、10 亿元、50 亿元、100 亿元的，经认定后分别给予最高不超过 200 万元、800 万元、1200 万元、1500 万元的一次性奖励，每上一个台阶奖励一次、实施晋档补差。

(3)对集成电路装备及材料类企业，年度销售收入首次突破 5000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元的，经认定后分别给予最高不超过 200 万元、800 万元、1200 万元、1500 万元的一次性奖励，每上一个台阶奖励一次、实施晋档补差。

以上(1)至(3)的支持措施，同一企业按照“从优不重复”原则自愿申报其中一类予以支持，且累计奖励金额不超过 1500 万元。

(4)鼓励集成电路龙头骨干企业进行产业链垂直整合，支持其开展境内外非关联的并购重组，成功并购国内外集成电路产业链相关企业或重点研发机构，超过 1000 万的按实际发生额 10%补贴，最高累计 1000 万元。

(5)对新片区内的非关联企业采购产品和服务的，且年采购金额累计在 500 万元以上，最高可按实际采购发票额 20%、给予采购方企业年度资助最高 1000 万元。

4、支持 EDA 软件购买和研发。对购买 EDA 设计工具软件(含软件升级费用)的企业并实际在临港新片区内开展办公研发的企业，按照实际发生费用的 50%，给予年度最高 200 万元的支持。对在新片区从事集成电路 EDA 设计工具研发的企业，给予 EDA 研发费用最高 50%的年度研发资助，总额不超过 3000 万元。

5、支持 IP 购买。对企业购买 IP(来源于 IP 提供商、EDA 供应商或者代工厂 IP 模块)开展高端芯片研发，给予 IP 购买实际支付费用 50%的资助，其中：对采用工艺制程 45nm 以上的、年度资助最高 300 万元，对采用工艺制程 45nm 以下的、年度资助最高 800 万元。

6、支持测试验证。对开展工程样片的功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析

等方面的测试验证及相关认证的单位，按实际发生费用的 50%给予支持、年度资助最高 200 万元。

7、支持企业流片。其中：

(1) 对于使用多项目晶圆(MPW)流片进行研发的企业，按 MPW 直接费用，给予每家企业(模拟类最高 100%、数字类最高 60%)年度总额不超过 300 万元的资助。

(2) 对于首次完成全掩膜(Full Mask: IP 授权费、掩膜版费、测试化验费、加工费等)工程产品流片的企业，给予流片费用最高 50%的资助，其中：对工艺制程在 45nm 以上的、年度资助总额不超过 600 万元，对工艺制程在 45nm 以下的、年度资助总额不超过 2000 万元。

8、支持推广应用。对于企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片产品销售金额累计超过 500 万元的，按当年销售金额最高 10%给予奖励，单款芯片产品年度奖励总额最高 500 万元。支持企业销售自主研发生产的集成电路关键核心设备和材料，按照销售金额的最高 30%、一次性给予最高 1000 万元的奖励。

9、支持生产性用电。对符合国家战略发展需要、经认定的集成电路封装测试、材料等生产型企业上一年度用电成本，按照“先交后补”的方式，给予用电费用 50%的支持，同一企业年度资助不超过 500 万元、补贴年限最多 3 年。

10、其他支持措施。建立临港新片区集成电路优势企业(单位)库并做相关分类，结合企业和项目实际精准施策、优先支持、组合扶持。组建专业服务团队，对入库企业(单位)辅导申报国家、上海市和临港新片区出台的各项资源要素(包括提高土地利用效率等)、财税金融(包括所得税、投融资、上市奖励等)、招商引企(包括企业落户、总部经济等)、人才(包括人才引进、培养培训、住(租)房保障、医疗保障、子女就学、奖励补贴等)、产业促进(包括关键核心技术与产品突破、产业能力提升等)、产教融合(包括“产学研”、技能人才培养等)、科技创新(包括功能平台、研发经费补贴奖励等)、全流程保税、数据跨境流动、研发用房补贴等方面扶持政策。

(来源：芯榜)

成都集成电路产业规模排名全国第五，高新区设定 2022 年 IC 目标

10 月 11 日，成都高新区党工委委员、管委会副主任赵继东围绕“成都高新区集

成电路产业发展研究”课题开展专题党课。

据成都高新区电子信息产业发展局消息，本次研究会着力发挥产业优势、补齐产业链短板，以集成电路产业为牵引，促进电子信息产业高质量发展。

赵继东提到，成都高新区已成为中西部地区集成电路产业发展高地，成都市集成电路产业规模排名全国第五，成都高新区承载了全市近 90%的集成电路企业，产业呈聚集发展态势。

据悉，高新区围绕“一区四园”总体布局，其中高新西区是成都电子信息产业功能区核心载体，重点打造集成电路、光电显示、智能终端、网络通信产业生态圈和电子科技大学协同创新平台等。

赵继东表示，为发挥集成电路产业的杠杆作用特别是 IC 设计领域的牵引作用，高新区将在产业调研和现有工作基础上加速推动 IC 设计产业发展，目标是在 2022 年 IC 设计产值突破 100 亿元，引进和培育数家龙头企业，形成北斗导航、IP、汽车电子等数个具有长期竞争力的特色优势领域，从而带动集成电路产业产值突破 1300 亿。

接下来将持续强化招商引资，以产业链协同为重点加速项目落地。

（来源：成都高新区电子信息产业发展局）

通知公告

1、关于举办集成电路专题培训班的通知

<http://www.hicc.org.cn/news-detail-337854.html>

2、中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见

http://jxj.hangzhou.gov.cn/art/2019/10/9/art_1692685_38698036.html

编辑部：杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北楼四楼 B4088 室

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司

邮政编码：310053

E-mail: incub@hicc.org.cn

电 话：86- 571- 86726360

传 真：86- 571- 86726367